

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2025-045

华海清科股份有限公司

关于投资建设晶圆再生扩产项目的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 新建项目名称：华海清科晶圆再生扩产项目（以下简称“本项目”）。
- 投资规模及金额：本项目规划扩建总产能为 40 万片/月，其中首期建设产能为 20 万片/月，首期投资预计不超过 5 亿元人民币，最终投资总额以实际投资为准，华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）将根据项目进展情况按需投入。
 - 资金来源：公司的自有和自筹资金。
 - 本项目建设周期预计不超过 18 个月，最终以实际开展情况为准。
 - 此次投资金额未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，公司将按照《公司章程》相关要求履行内部审批流程。
 - 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
 - 相关风险提示：
 - 1、晶圆再生需求受下游半导体厂商稼动率影响较大，如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网等终端市场需求下降，芯片制造厂商稼动率将下降，从而减少再生晶圆的需求量，对公司晶圆再生业务的发展带来需求波动风险。
 - 2、本项目将新增折旧摊销费用，如因市场环境变化或公司经营管理不善等原因导致本投资项目投产后不能如期产生收益或盈利水平不及预期，新增生产成本和费用可能将增加公司经营风险。

3、本项目尚需履行国资审批程序，办理环评等相关手续，项目建设开工、建设完成时间尚不确定。

敬请投资者注意投资风险。

一、投资建设项目的的基本情况

（一）项目概况

为有效抢抓晶圆厂加速扩产的窗口期，扩大先发优势和规模效应，进一步扩大晶圆再生服务的市场份额，公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为 40 万片/月，其中首期建设产能为 20 万片/月，首期投资预计不超过 5 亿元人民币。

（二）项目基本情况

1、项目名称：华海清科晶圆再生扩产项目。

2、项目实施主体：公司将根据项目规划新设全资子公司实施本项目。

3、项目实施地点：拟选址于江苏省昆山市经济技术开发区（以最终方案确认为准）。

4、项目投资规模及来源：本项目计划首期投资金额不超过 5 亿元人民币，资金来源于公司的自有及自筹资金。

5、项目实施方式：本项目由公司新设全资子公司实施，授权公司管理层根据项目进展通过增资、借款或项目贷款等方式投入。

6、项目建设周期：本项目建设周期预计不超过 18 个月，最终以实际开展情况为准。

（三）项目建设必要性和可行性分析

1、国家政策支持行业发展

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业，近年来国家出台了一系列鼓励政策以推动我国集成电路的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，为行业发展提供了政策支持，营造了良好的政策环境，有效保障项目的落地实施。

2、前瞻性布局扩大规模优势

公司以自有化学机械抛光（CMP）装备和清洗装备为依托，针对下游客户生产线控片、挡片的晶圆再生需求，积极拓展晶圆再生业务，目前已成为具备 Fab

装备及工艺技术服务晶圆再生专业代工厂，现有晶圆再生产能已达 20 万片/月左右，近年来获得多家大生产线批量订单并长期稳定供货。随着国内 12 寸晶圆厂加速扩产，新建产线的工艺要求越来越高，相应对挡控片、测试片的需求激增，公司需进一步提高晶圆再生加工能力以便更好地响应客户的需求。

3、先进的技术优势

CMP 和清洗是晶圆再生工艺流程的核心，通过采用先进的 CMP 研磨方式，大幅提升再生晶圆的循环使用次数，获得客户的高度认可，在先进制程晶圆再生服务方面具有更强竞争力，已取得多家大型重点客户的订单。

（四）与主营业务关联分析

晶圆再生工艺流程主要是对控挡片进行去膜、粗抛、精抛、清洗、检测等工序处理，使其表面平整化、无残留颗粒。晶圆再生的工艺流程中，主要粗抛、精抛、清洗是通过公司 CMP 装备及清洗装备完成的，CMP 和清洗技术是晶圆再生工艺流程的核心；同时 CMP 装备及清洗装备也是晶圆再生工艺产线中资金投入最大的装备，公司可以通过定制化装备降低资本投入。

晶圆再生客户主要是集成电路制造厂，与公司现有装备业务的客户群高度重合，公司已经与国内集成电路制造厂建立良好的合作关系，客户对公司装备产品的工艺认可为晶圆再生业务奠定了良好的市场拓展基础。因此，基于公司多年积累的 CMP 及清洗工艺技术优势、自产装备成本优势及同客户群的市场拓展优势，晶圆再生业务与公司现有装备业务在市场和技術方面都具有很高的协同性。

（五）主要风险分析

1、晶圆再生需求受下游半导体厂商稼动率影响较大，如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网等终端市场需求下降，芯片制造厂商稼动率将下降，从而减少再生晶圆的需求量，对公司晶圆再生业务的发展带来需求波动风险。

2、本项目将新增折旧摊销费用，如因市场环境变化或公司经营管理不善等原因导致本投资项目投产后不能如期产生收益或盈利水平不及预期，新增生产成本和费用可能将增加公司经营风险。

3、本项目尚需履行国资审批程序，办理环评等相关手续，项目建设开工、建设完成时间尚不确定。敬请广大投资者注意投资风险。

二、对公司的影响

公司拟新设全资子公司实施“华海清科晶圆再生扩产项目”，将有效抢抓晶圆厂加速扩产的窗口期，扩大先发优势和规模效应，进一步扩大公司晶圆再生产能力和市场份额，为公司和股东获取更多的投资回报，提升公司业绩和持续经营能力，不存在损害公司和股东利益的情形。此次投资金额未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，也不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 28 日